

# 電力変換

## Power conversion

軽量化、開発スピードUPに貢献

Contributes to weight reduction and improved development speed

冷却性・絶縁性を確保し軽量・小型化

Reducing weight and size while ensuring cooling and insulation

熱流体解析技術と材料技術を応用  
Application thermo-fluid analysis and materials technology

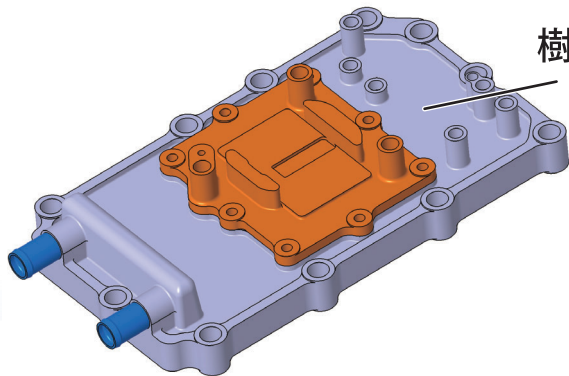
開発中 Under development

樹脂製半導体モジュール

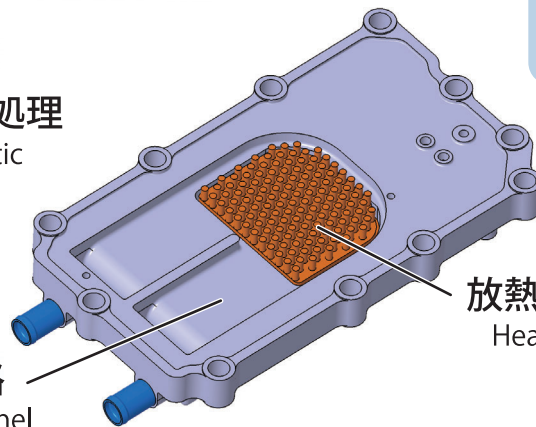
Resin semiconductor module

開発目標 Development target

軽量化 -30%  
Weight reduction 30%



樹脂+電磁波遮蔽処理  
Resin+Electromagnetic wave shielding



冷却水路  
Cooling channel

放熱フィン  
Heat sink



詳細はこちらをクリック

3Dモデル共有による一気通貫の開発とSE<sup>※</sup>設計提案

Development and SE design proposals sharing 3D models from start to finish

※SE: Simultaneous engineering

インバーター  
ケース

Case, inverter

